



H2153

环氧导电银胶

H2153 是一款室温下可快速固化的导电银胶，可以通过点胶、刷涂、笔画等工艺在玻璃，陶瓷，ITO，金属等基材上制成导电路径。银胶具有良好的附着力和优异的导电性能，可用于 PCB 板导电路径的设计和修复，触点搭接；尤其适用于 LCD，LCM 行业，智能手机、平板等产品显示模块的导电连接。

产品描述

产品特性

条目	描述
外观	银灰色浆料
组分	单组分
固化方式	室温固化
典型的产品应用	LCD 显示模组等

产品优点

- 存储稳定，抗沉降性能优异
- 优异的点胶性能；无断线、堵针头不良
- 可室温快速固化
- 良好的附着性能
- 符合RoHS法规

产品性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	~7,000	GB/T 2794 Brookfield, 转速20 rpm
比重 g/ml	约 1.52	GB/T 13354
触变指数 TI	2.8	GB/T 2794 5/20rpm
表干时间 (min)	10	@ 25°C 指触法
体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	11×10^{-3}	两点探针法



使用方法

搅拌: 如冷藏存储, 使用前需将银浆恢复至室温并用行星式搅拌设备分散均匀, 避免冷凝水汽进入

点胶: 确保基材表面洁净, 可用 0.2mm-1.0mm 针头连续打点、划线;

固化: 在干燥通风的条件下, 室温 10min 内可快速表干固化

标准包装

- 5ml / 支, 10ml / 支, 30ml / 支
- 按客户需求包装

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内, 并存放在阴凉、干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件: 5-10°C, 存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染, 请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息, 请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注: 本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果, 我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外, 及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题, 包括针对某一特殊用途的适用性问题, 我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com